



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号

版本

页码

发行日期

A.0

第1页 共4页

2021.9.2

文件名称

产品规格书

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating

12VAC (rms) / DC

Contact Resistance

50Milliohms Max.

Withstanding Higt Temperature

280°C

Operational Temperature

- 40°C~+85°C

三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	针体	黄铜	镀金 1.5u'
2			
3			

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版本	A.0
		页码	第2页 共4页
文件名称	产品规格书	发行日期	2021.9.2

1. 适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZB0039-08614-01连接器。

2. 产品描述:

2.1 材料: 针体: 磷铜

3. 机械性能

序号	测试项目	测试描述	结果
1	外观	根据EIA-364-18, 目视条件下。	表面光亮, 没有裂纹, 没有剥金和变形等不良现象。

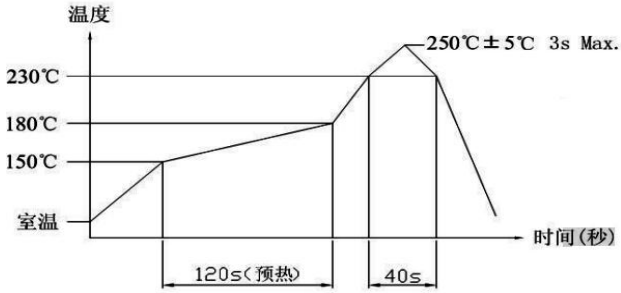
4. 电气特性

序号	测试项目	测试描述	结果
1	接触阻抗	根据EIA-364-23, 电压20mV, 电流10mA条件下测量接触电阻。	最大50mΩ。
2	抗电流能力	根据EIA-364-70, 通12V, 1A电流(静态)。	无破坏, 烧坏等不良现象。

5. 环境测试

序号	测试项目	测试描述	结果
1	抗湿能力	根据EIA-364-31, 在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。
2	冷热冲击	根据EIA-364-32, 从-40℃到 +105℃进行5个轮回。	无破坏, 疲劳等不良现象。
3	可焊性	根据EIA-364-52, 浸入265±5℃, Sn-Ag-Cu焊锡, 持续4.0~5.0秒。	碰到锡的部位粘锡率95%以上。
4	盐雾测试	根据EIA-364-26, 测试条件: 5%盐水保持48小时。	无氧化, 腐蚀, 生锈等不良现象。

6. 回流焊测试

测试说明	回焊炉曲线图	结果
按右图之曲线设定温度, 当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中, 达到指定时间后产品自动送出。		焊接完成后, 本体粘锡良好, 无变形, 起泡现象, 满足机械、电器性能。

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版本	A.0
		页码	第4页 共4页
文件名称	散装类产品包装规范	发行日期	2021.9.12

1、目的：

规范公司产品包装作业的运用，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器，同时选择合适的附属包装材料来包装产品，要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装单针数
1	外包装箱（小）	12.5cm*12.5cm*6cm	1	10000PCS
	外包装箱（大）	25.5cmx20.3cmx16.4cm	1	100000PCS
2	防静电袋	9x6, 12x8, 16x11 17x14, 23x16		若干
3	气泡袋	22mmx17mm		若干
4	透明胶带	45mm		若干
5	标签	65mmx44mm		1张/袋
6	其他填充物	/		若干

5、包装步骤及注意事项：

1，打印好标签，标识应当清晰，易懂，字体需一致。根据产品大小选择合适的防静电袋，包装数量不应超过最大包装数量的70%，包装数量应取百或千的整数，以方便记录。标签统一贴在包装袋的正中间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保护。



2，将外包装箱折好(注意箱子的向)，用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱中，如有多层，每层的数量需一致，完成后如局部位置有空隙，需用填充物填满，产品在包装箱内不能晃动。



3，填充完成后，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Contact Probes](#) category:

Click to view products by [Xinyangze](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CT5253](#) [S-4-C-5-G S/C](#) [SS-75-B-2.4-G](#) [ICT-100-J-17-G](#) [300106-000-1103](#) [ICT-100-A-8-G S/C](#) [ICT-075-B-10-G-S S/C](#) [S-2-D-8.3-G D/C](#)
[ICT-100-T-8-G S/C](#) [S-0-B9-2.5-G S/C](#) [SS-40-J-2.4-G D/C](#) [S-0-V-3.7-G S/C](#) [SX-1-U-6.6-G D/C](#) [SS-50-J-5.1-G S/C](#) [SS-40-J-1.8-G-N/L D/C](#)
[SS-3-7-G S/C W/HOLE .373 OAL](#) [SS-10-7-G S/C W/HOLE .373 OAL](#) [SS-1-7-G S/C W/HOLE .385 OAL](#) [SHE-5-H-18.7-G](#) [SHE-5-B-18.7-G](#)
[SHE-3-A-7-G](#) [SH-4-A-10-G S/C](#) [101057-001-952](#) [S-50C-HS-4.3-DG-S](#) [S-5-F-8-G S/C SS SPGS](#) [S-5-F-16.4-G S/C](#) [S-4-K-5-G S/C](#) [S-4-E-5-](#)
[D S/C](#) [S-2-J-8.3-G D/C](#) [S-2-E-10-D D/C](#) [S-2-A-10-D D/C](#) [S-100-UR-5.5-G-S](#) [S-100-T-8-RT](#) [S-100-J-17-G](#) [S-100-HK-10-G](#) [S-100-D-6.7-G](#)
[S-100-B-3.5-G-S](#) [S-100-B-3.5-G](#) [S-1-U-6.6-D D/C .670 OAL](#) [S-1-A-6.6-D D/C .670 OAL](#) [S-075-S-3.8-RT](#) [S-075-J-3-G](#) [S-075-B-3-G](#) [S-075-](#)
[A-7-G](#) [S-00-U-1.6-G D/C SS SPG](#) [S-00-ES-2-G D/C](#) [S-0-U-3.7-D S/C](#) [RX-100-SC](#) [RH-100-WW-429](#) [QUAD-0C-12-1](#)